ISOLATION i35

FICHE TECHNIQUE : FIBRAN XPS

La plaque rigide haute performance en polystyrène extrudé.

NotebookLM

Les Trois Piliers d’Excellence



Performance Thermique

Isolation thermique supérieure et continue.

Faible conductivité garantissant une protection énergétique optimale des structures.



Résistance Structurelle

Résistance mécanique élevée face aux charges lourdes. Plaque rigide à la fois légère et facile à manipuler sur chantier.



Protection Durable

Faible absorption d'eau.

Protège durablement l'enveloppe du bâtiment contre l'humidité et les contraintes mécaniques extrêmes.

NotebookLM

Spécifications Paramétriques

0,033 - 0,036

W/m·K | Conductivité thermique

300

kPa | Contrainte de compression (à 10% de déformation)

1,25 × 0,60

m | Dimensions standard

5 → 20

cm | Épaisseurs disponibles

30 - 45

kg/m³ | Densités

E

Ignifugé | Normes EN 13163, ISO 4898

NotebookLM

Domaines d’Application



Enveloppe Globale (Murs, Sols et Toitures)

Isolation thermique continue pour l’intégralité de l’enveloppe du bâtiment, supprimant les ponts thermiques.



Infrastructures et Parkings

Idéal pour les parkings et zones soumises à de fortes charges mécaniques grâce à sa haute résistance à la compression.



Planchers Chauffants

Parfaitement compatible avec les systèmes de plancher chauffant, optimisant la diffusion thermique.

Notel NotebookLM

Votre Équipe Dédiée

Chargée d’affaire
+216 52 726 401

Directeur Commercial
+216 52 726 727

Directeur Financier
+216 52 723 724

Architecte Conseillère
+216 51 726 411

Pour toute information technique ou commerciale, notre bureau d’études est à votre entière disposition.

Gemini Notebook